

【事例】

CT撮影による 20層基板銅箔パターン分離

2020年4月17日
株式会社 ビームセンス

1. 条 件

■ 撮影サンプル

- 20層2.8mm厚プリント基板

■ 撮影および断層像

1. CT撮影: FLEX-MH867

4CCD結合、幾何拡大率 = ×4.7、1.08度ピッチ × 337回 撮影

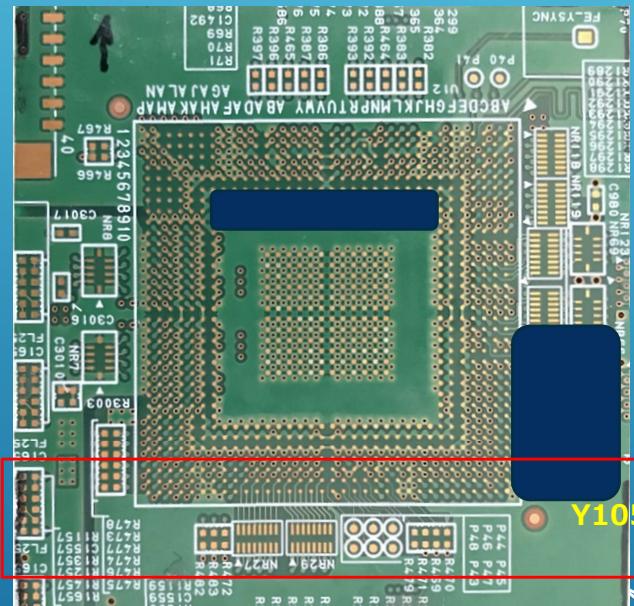
2. 3次元画像再構成処理: BSTソフト

再構成分解能 (20μm/pixel)

3. スライス方向: Z軸方向、XZスライス

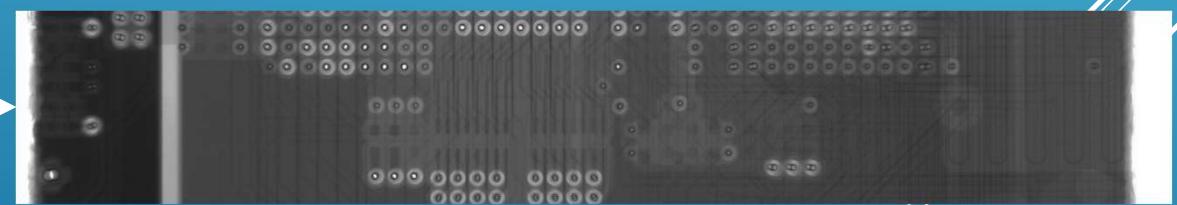
■ サンプル外観と透過X線画像

【外観】



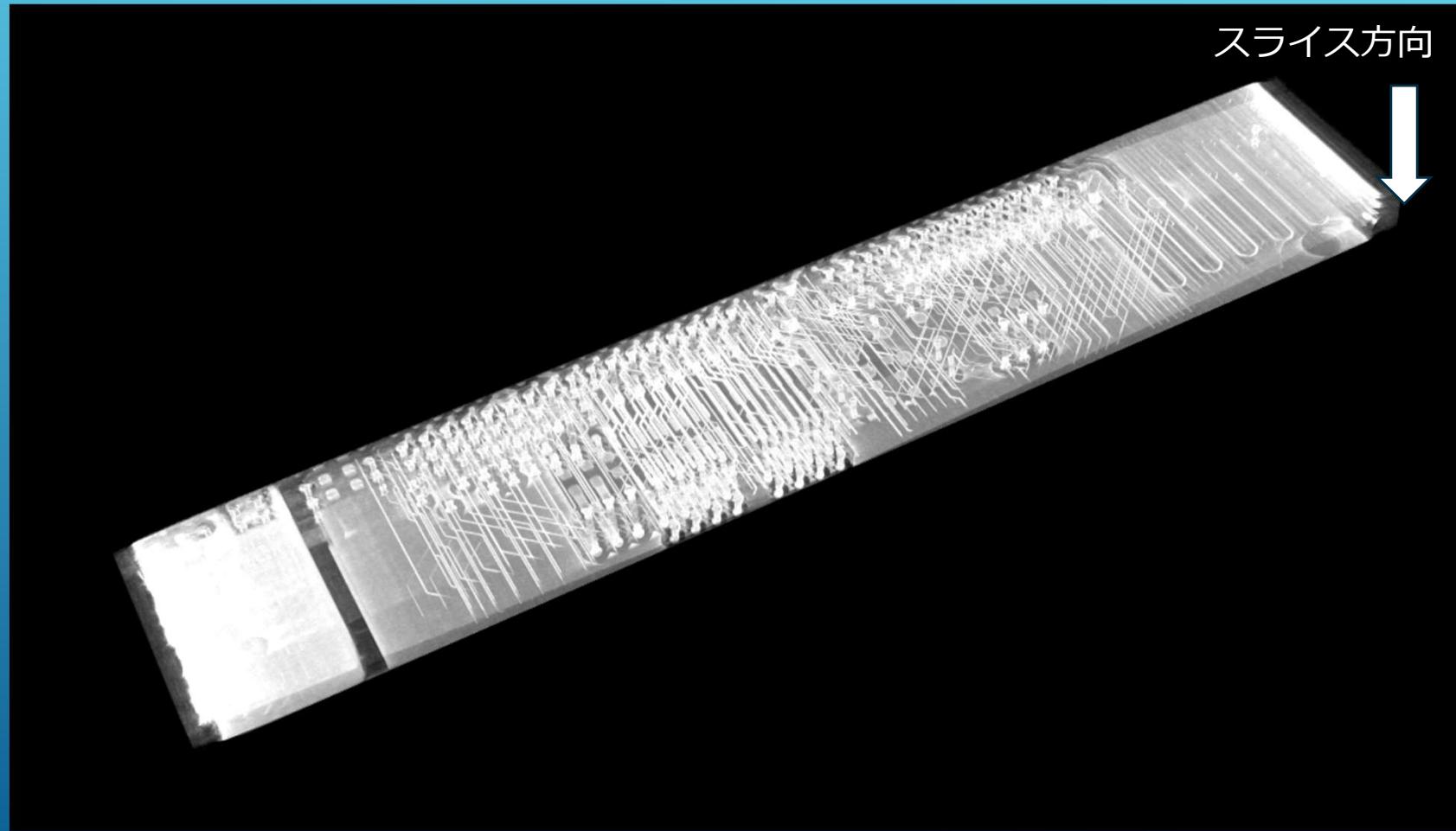
55 mm

【透過X線画像】

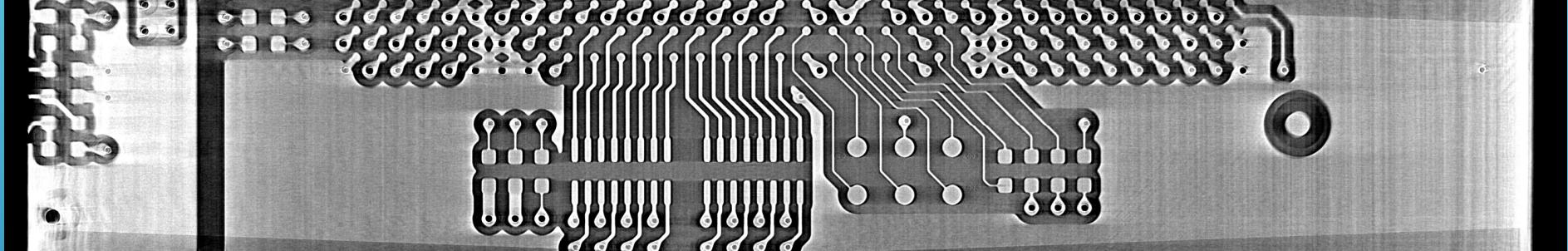
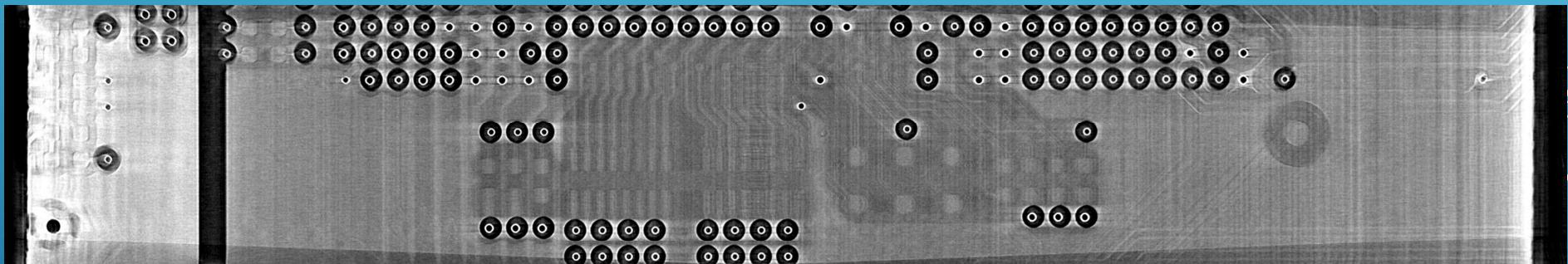
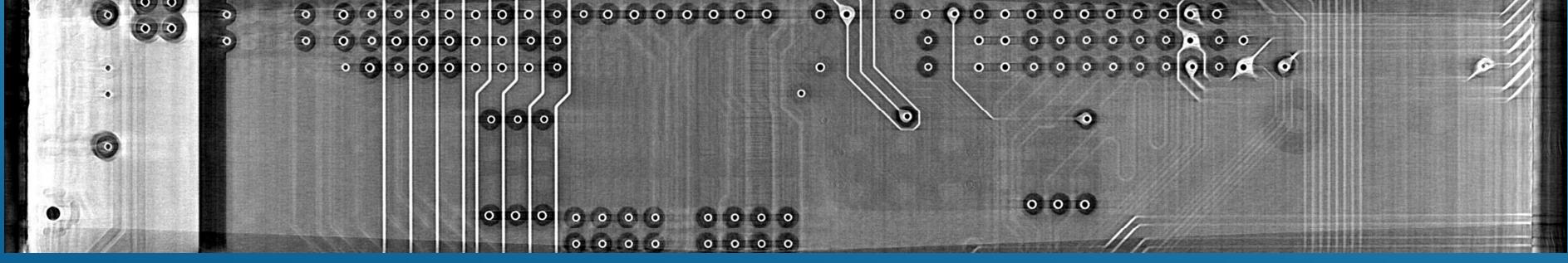


撮影範囲

■ 3D X線画像

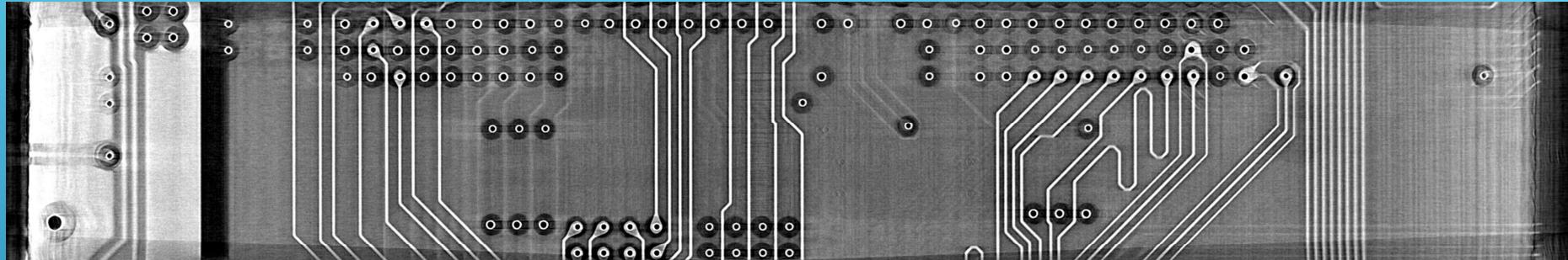


■ スライス画像 Y105

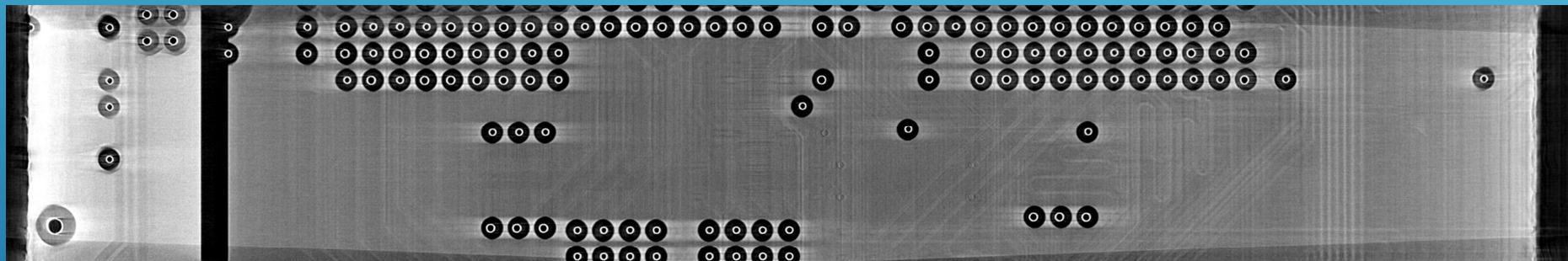
1層	
2層	
3層	

■ スライス画像 Y105

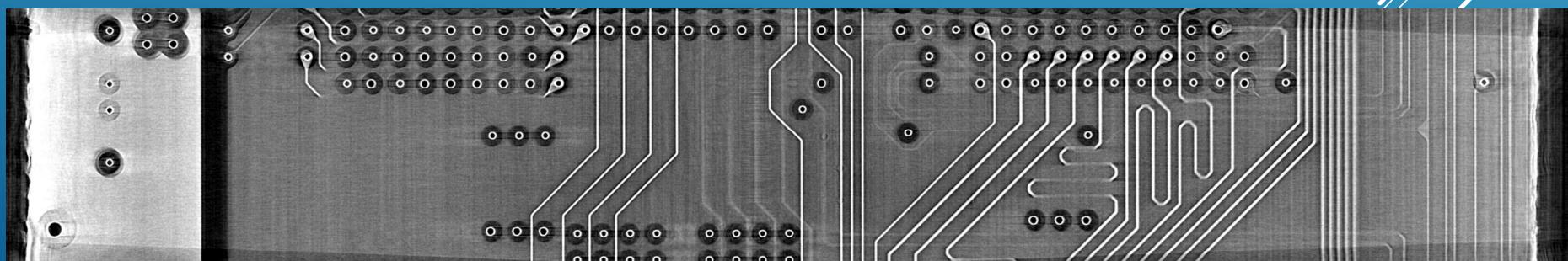
4層



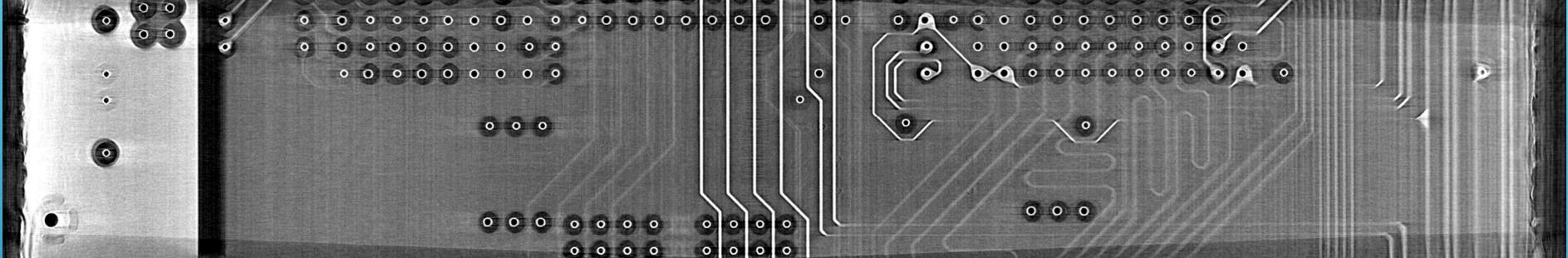
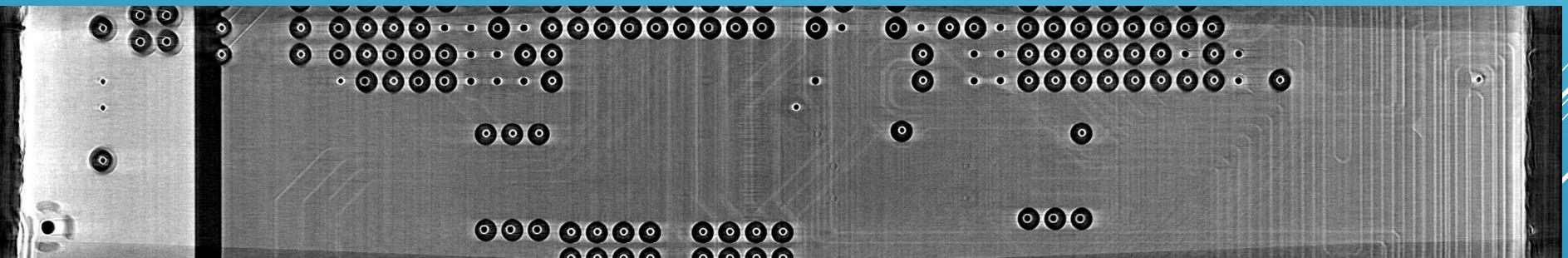
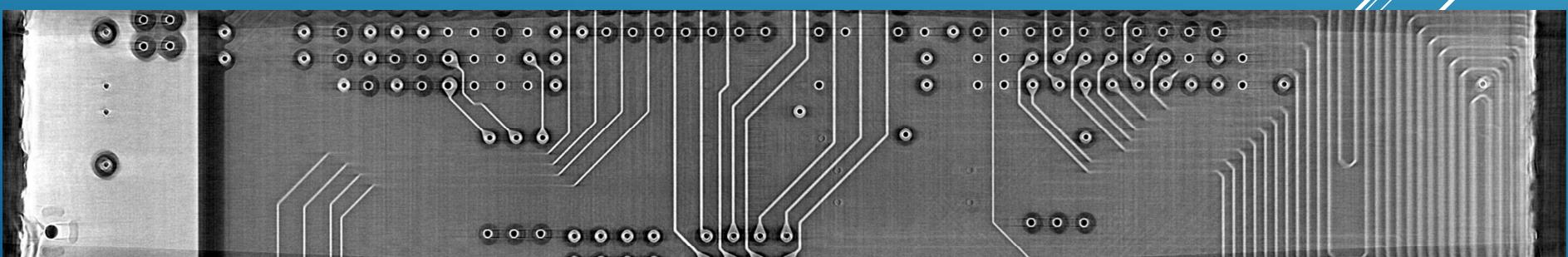
5層



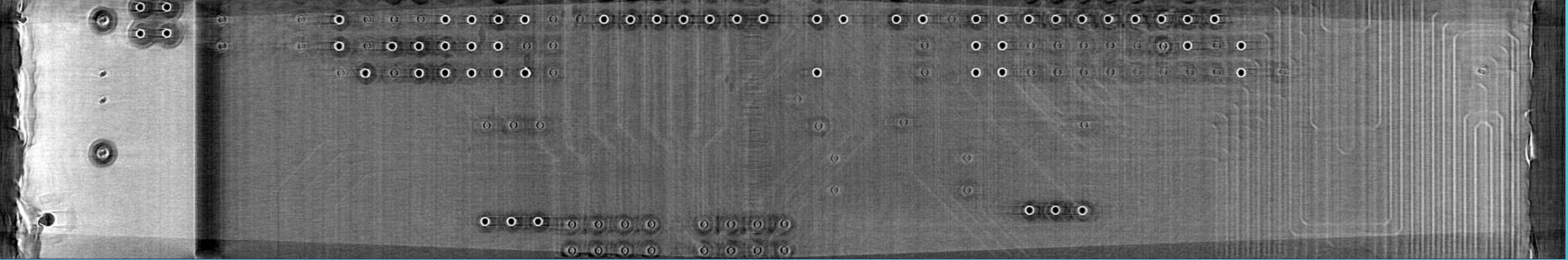
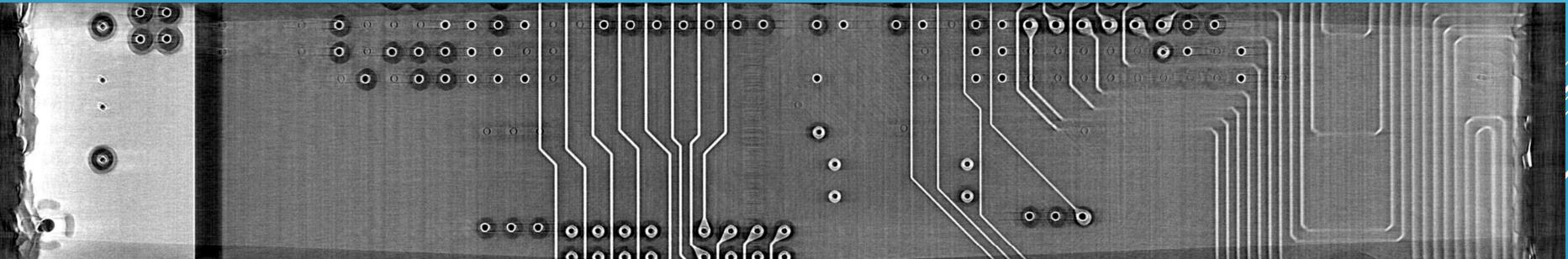
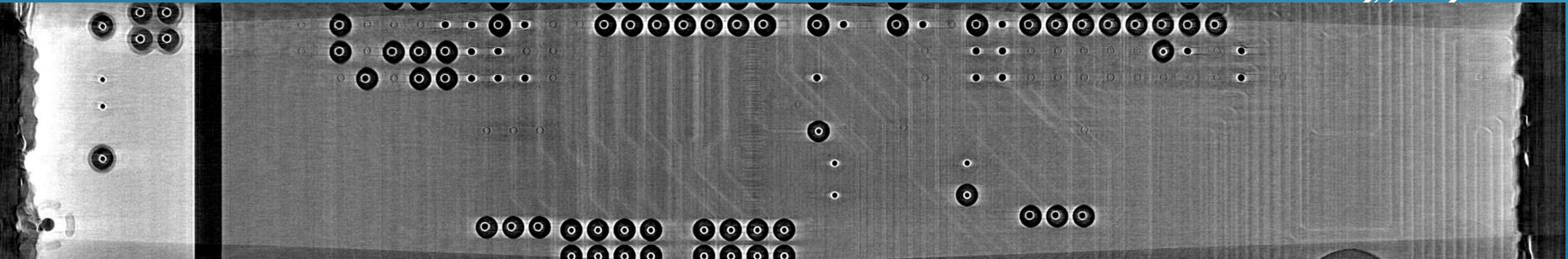
6層



■ スライス画像 Y105

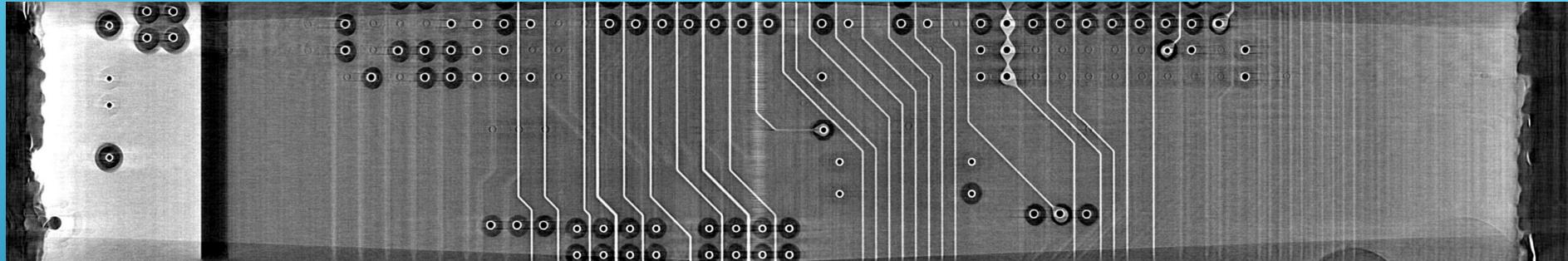
7層	
8層	
9層	

■ スライス画像 Y105

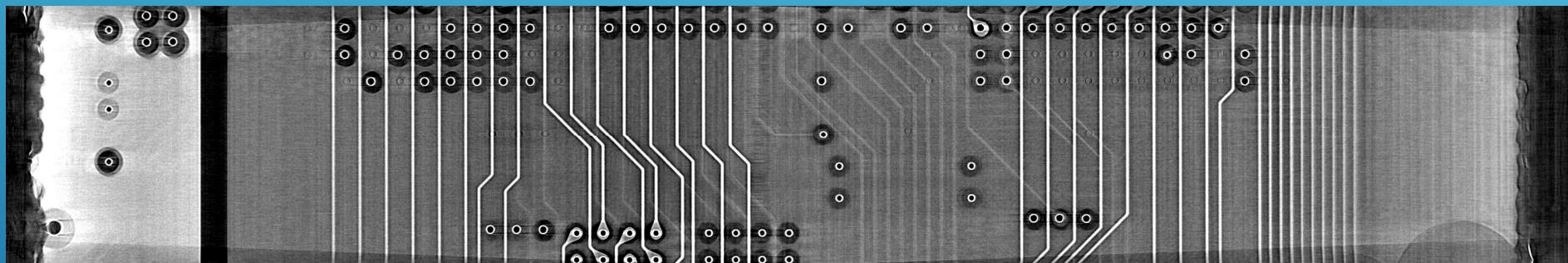
10層	
11層	
12層	

■ スライス画像 Y105

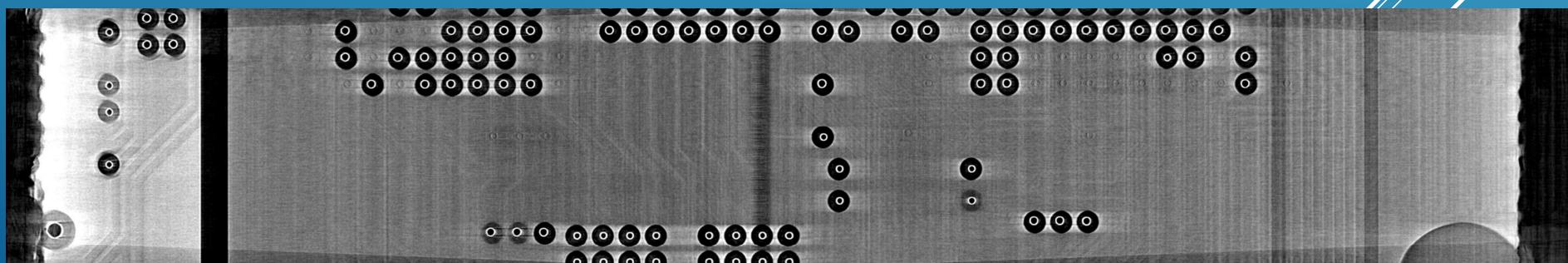
13層



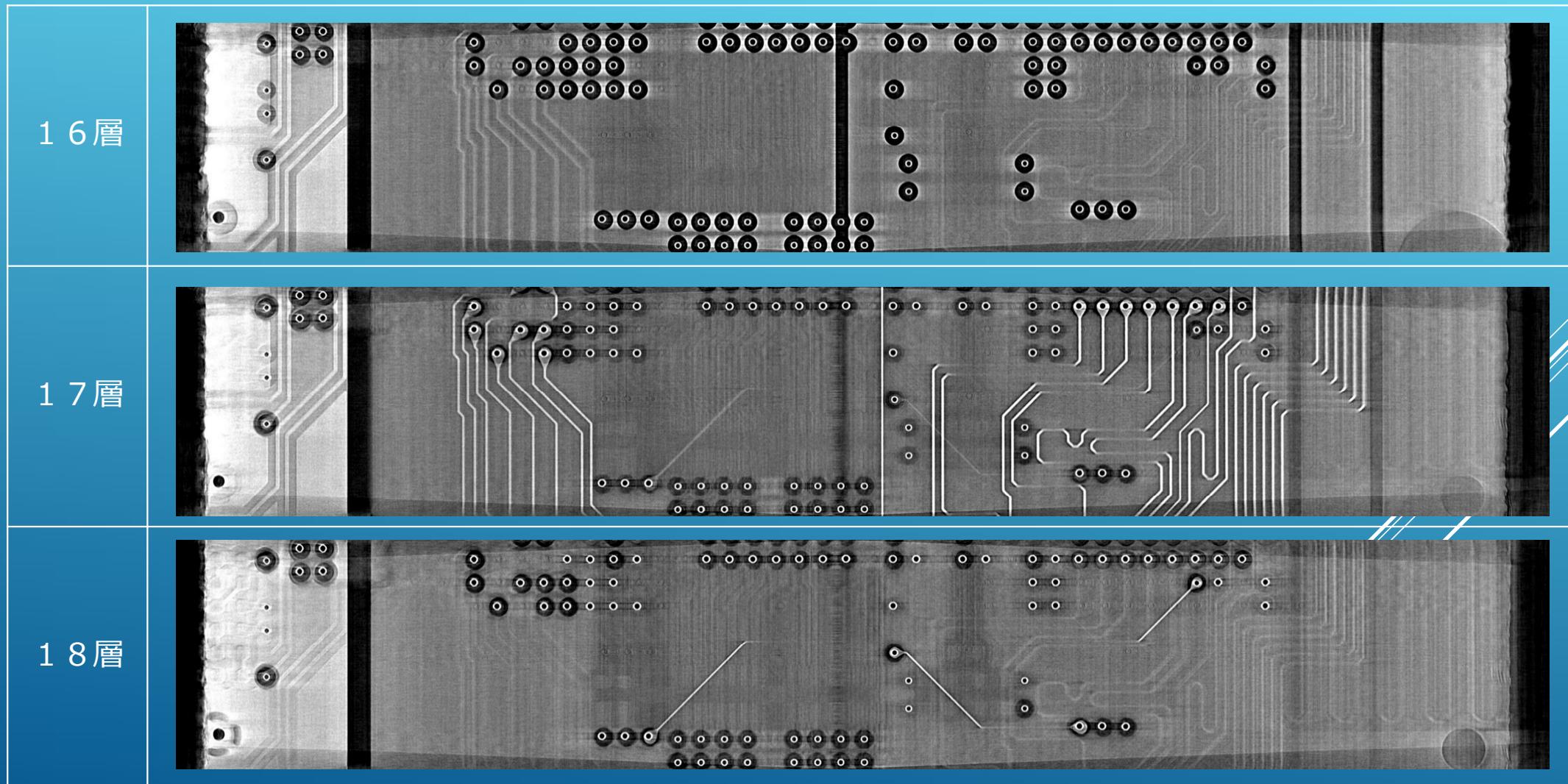
14層



15層

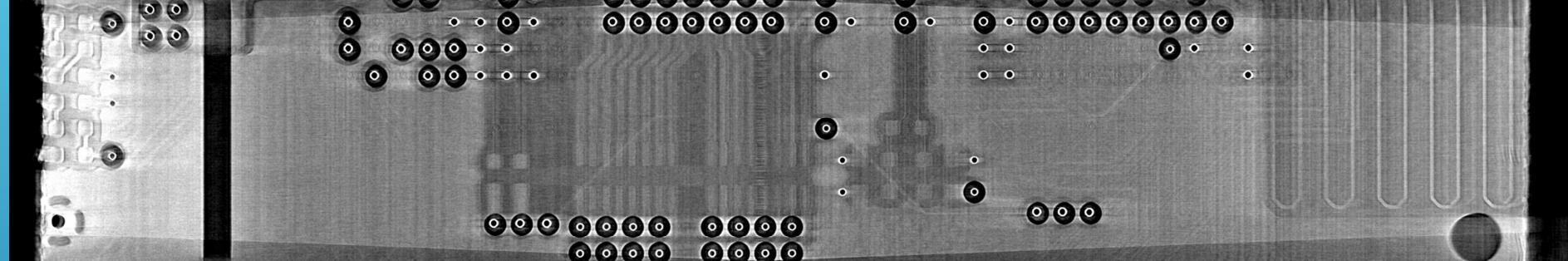


■ スライス画像 Y105

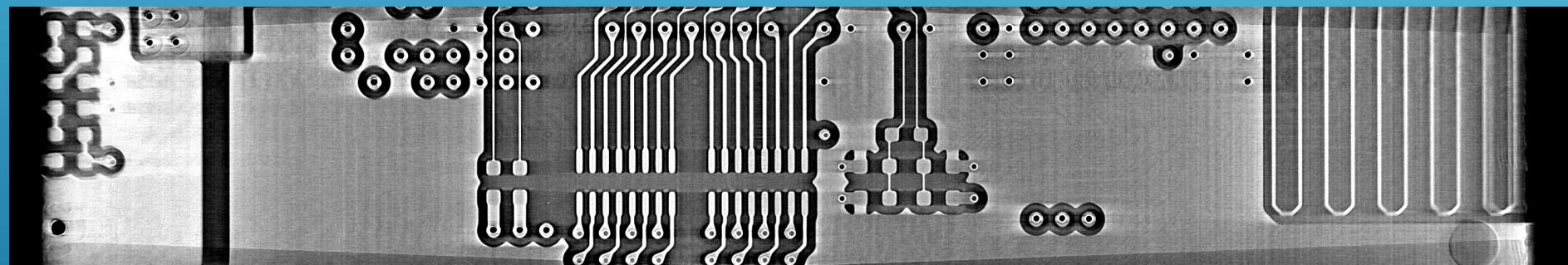


■ スライス画像 Y105

19層



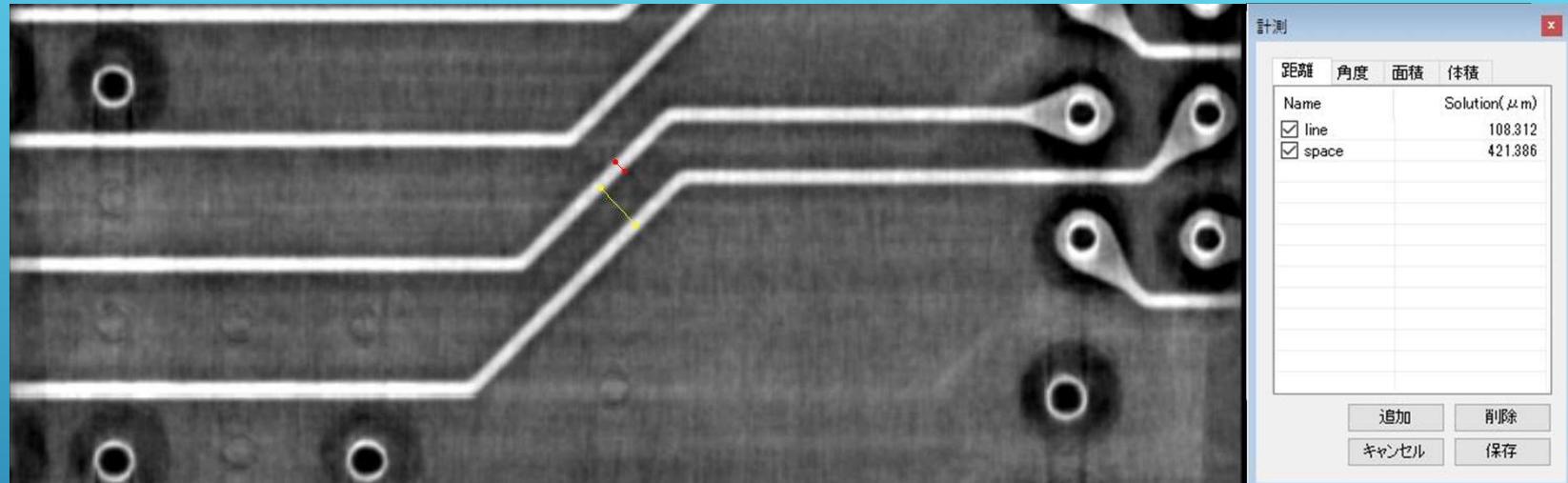
20層



■ 計測

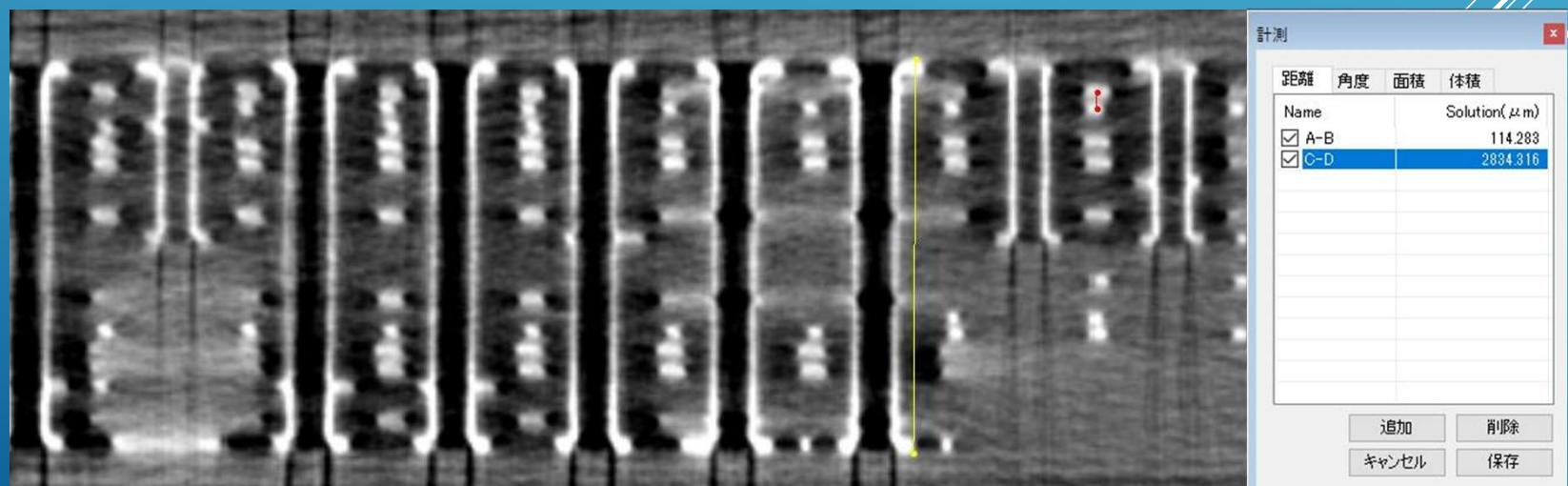
◆ 1~4層

Line = 108 μm
Space = 420 μm



◆ 斷面

層間 = 114 μm
基板厚 = 2,834 μm



【お問い合わせ先】

株式会社 ビームセンス
BEAMSENSE CO.,LTD.

〒564-0041 大阪府吹田市泉町2-19-16

2-19-16 Izumi-cho , Suita City , Osaka 564-0041,Japan

info@beamSense.co.jp